

## Intel prepara X299



**LINK (<https://www.nexthardware.com/news/processor-chipset/7809/intel-prepara-x299.htm>)**

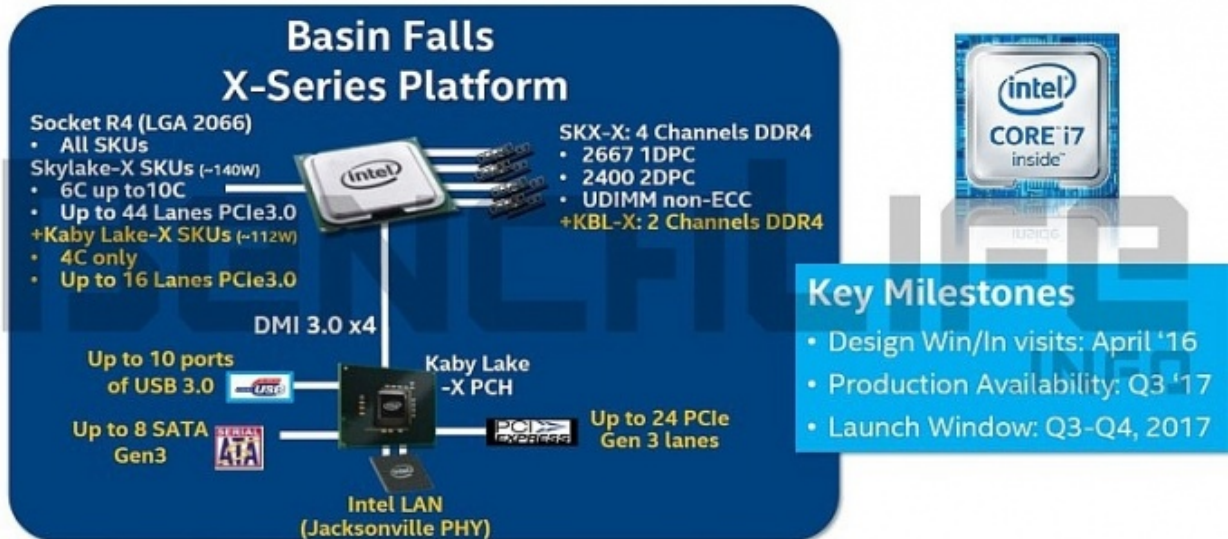
Nuovo chipset, ma anche nuovo socket LGA 2066 per la prossima piattaforma HEDT.

L'attuale offerta Intel per il mercato Desktop, lo sappiamo, è articolata in due principali piattaforme, una intesa per coprire dalle esigenze di ogni giorno sino a quelle legate al gaming, con i processori dual e quad core per socket LGA 1151, ed una di tipo professionale con i processori da sei a dieci core su socket LGA 2011-v3.



Seguendo l'approccio Intel Tick-Tock (che parrebbe ancora valido, quantomeno per i ritmi del mercato HEDT), siamo in attesa di una nuova architettura, Skylake-X, precedentemente nota come Skylake-E, che porterà con sé la necessità di un nuovo socket, indicato come LGA 2066.

## Basin Falls X-Series Platform Overview



Con il nuovo socket sarà lanciato un nuovo chipset con il nome commerciale di X299, restituendo una certa congruenza all'offerta Intel per i PCH, che d'ora in avanti rientreranno tutti nella nomenclatura 200-series.

In virtù di uno stesso processo produttivo a 14nm, possiamo attenderci un'offerta sulla falsa riga di quella attuale, con soluzioni a 6, 8 o 10 core da 140W di TDP.

Come se non bastasse, con X299 Intel si starebbe preparando al lancio anche di Kaby Lake-X, CPU a 4 core realizzate sulla base di un'architettura più recente e migliorata nell'IPC rispetto a Skylake.

Si tratta di una mossa del tutto inedita per Intel, che non aveva mai riconosciuto questo segmento di mercato e lasciato le soluzioni quad core esclusivamente relegate alle piattaforme mainstream, ma che sembra ora decisa ad offrire un prezzo di lancio inferiore per la sua piattaforma top di gamma Basin Falls, probabilmente per controbattere alle prossime mosse di AMD.

## Desktop Processor Comparison

	Kaby Lake-S	Broadwell-E	Kaby Lake-X	Skylake-X
CPU Cores	4	6, 8, 10	4	6, 8, 10
CPU LL Cache	8 MB	Up to 25 MB	8 MB	13.75 MB
PCIe Processor	PCIe 3.0 16 lanes	PCIe 3.0 40 / 28 lanes	PCIe 3.0 16 lanes	PCIe 3.0 44 / 28 lanes
Discrete Gfx Configurations	1x16, 1x8+2x4	2x16+1x8 1x16+1x8+1x4	1x16, 1x8+2x4	2x16+1x8+1x4 1x16+1x8+1x4
Integrated Graphics	Yes	No	No	No
TDP	95 W	140 W	112 W	140 W
Socket	LGA1151	LGA2011-3	LGA2066	LGA2066
Chipset Support	KBL PCH-H	X99	KBL PCH-X	KBL PCH-X
Technologies	Turbo Boost 2.0	Turbo Boost 3.0	Turbo Boost 2.0	Turbo Boost 3.0
Memory	DDR4-2400	DDR4-2400	DDR4-2666 (1 D/Ch) DDR4-2400 (2 D/Ch)	DDR4-2666 (1 D/Ch) DDR4-2400 (2 D/Ch)



Kaby Lake-X sarà caratterizzato da 16 linee PCI-E 3.0 e toccherà quota 112W, un valore importante considerata la configurazione e l'assenza di chip grafico integrato, forse utile al raggiungimento di maggiori frequenze rispetto a Kaby Lake su Z270, ma condividerà la compatibilità con le memorie di classe DDR4 2666 Quad Channel standard per Skylake-X ed X299.

Skylake-X, Kaby Lake-X e X299 sono attesi per la seconda metà del 2017 con prezzi presumibilmente a partire da 350 dollari.